

Nistec Sunday Training

4th Round



הזמנה

קבוצת ניסטק, מזמינה אותך להשתתף ללא תשלום בתוכנית ההדרכות ללקוחות

במסגרת "Nistec Sunday Training"

בימי ראשון בין השעות 15:00-17:00

בחדר ההדרכה של החברה ברח' נבטים 12, קרית מטלון, פ"ת.

ההדרכות אינן כרוכות בתשלום • יש להירשם מראש על מנת להבטיח את מקומך • מספר המקומות מוגבל

| שם ההדרכה | תיאור | נושאים שילמדו | קהל היעד |
|---|---|---|---|
| DFA (Design for Assembly) יום ראשון Sunday 1.11.2009 | במהלך הדרכה זו, ירכשו המשתתפים ידע רב על שיקולים מהותיים הנדרשים לבחינה בשלב תכנון המעגל לטובת השגת ייצור והרכבה ללא תקלות במינימום זמן. מרצה: ארבל ניטן COO ניסטק דיזיין | <ul style="list-style-type: none"> SMT Technology Design for Manufacturing Panel Utilization Component Orientation Component Location Fiducials Multipanel Design Design for Inspection | <ul style="list-style-type: none"> מהנדסי פיתוח חומרה אנשי הנדסה אנשי ייצור אנשי תפ"י מהנדסי מערכת מנהלי פרויקטים |
| Hardware Based Voice Recognition יום ראשון Sunday 15.11.2009 | טכנולוגיית הזיהוי דיבור (Voice Recognition) צוברת תאוצה בשנים האחרונות במגוון יישומים אלקטרוניים. הדרכה זו תאפשר למשתתפים בה לרכוש ידע בנושא הטמעת יכולת דיבור וזיהוי דיבור במוצרים קיימים וכן כיצד ליישם יכולות אלו בפיתוח מוצרים חדשים. מרצה: ניר דבש מנכ"ל וורבל משינס בע"מ | <ul style="list-style-type: none"> Voice Recognition Background Speaker Dependent Vs. Speaker Independent Cost of adding VR to a product Correct Product Gameplay Live Products Demos | <ul style="list-style-type: none"> מהנדסי פיתוח חומרה מנכ"לים ראשי צוות חומרה אנשי מכירות |
| HDI and High Speed PCB Design יום ראשון Sunday 29.11.2009 | תכנון מעגלים אלקטרוניים מורכבים המאופיינים בצפיפות גבוהה ובתדרים מהירים, טומן בחובו אתגרים טכנולוגיים רבים. במהלך ההדרכה ילמדו המשתתפים על נושאים טכנולוגיים אותם כדאי לקחת בחשבון כחלק מתכנון כרטיסים אלו. מרצה: יבגניי מכלין CTO ניסטק דיזיין | <ul style="list-style-type: none"> Keys in BGA placement and routing Track & Holes Sizes Blind/Berried via (Rules and Definition) Control Impedance (Calculation and Application) Design for Manufacturing Signal Integrity Back Drilling Technology Best Practices | <ul style="list-style-type: none"> מהנדסי פיתוח חומרה אנשי הנדסה אנשי ייצור |
| DFT (Design for Testability) יום ראשון Sunday 20.12.2009 | במהלך הדרכה זו, ירכשו המשתתפים ידע רב על סוגי התקלות בכרטיסים אלקטרוניים והאמצעים לאתר אותם וכן המלצות לתכנון נכון לבדיקות. מרצה: יואן טורוק מהנדס בדיקות ניסטק מרכז | <ul style="list-style-type: none"> Basic Principles of Design for Testability Testability Enhancement Techniques ICT Guidelines Boundary-Scan (JTAG) Guidelines | <ul style="list-style-type: none"> מהנדסי פיתוח חומרה אנשי הנדסה אנשי ייצור אנשי תפ"י מהנדסי מערכת |
| Thermal Processing יום ראשון Sunday 3.1.2010 | השפעת הפרמטר התרמי בתכנון והרכבת מעגלים מודפסים הינו משמעותי ביותר בהצלחת הרכבת הכרטיס האלקטרוני. במהלך הדרכה זו יוקנה למשתתפים ידע בתכנון נכון של הכרטיס להלחמה אוטומטית, אפיון פרופיל טמפרטורה נכון, דוגמאות וכן המלצות מעשיות. מרצה: Jean Metsch מנכ"ל JMT | <ul style="list-style-type: none"> Solder Reflow The dT problem Component Heating Rates Designing for Assembly Recommendation & Application | <ul style="list-style-type: none"> אנשי הנדסה אנשי ייצור אנשי תפ"י מהנדסי מערכת מהנדסי תהליך מנהלי פרויקטים |
| Repair & Rework of BGA, uBGA, QFN, LGA יום ראשון Sunday 17.1.2010 | בהדרכה יוסבר למשתתפים תהליך ביצוע תיקון והחלפת רכיבים מוכללים כגון: uBGA, BGA, QFN, LGA, אפיון הטכנולוגיות השונות וכן השיקולים בביצוע תהליך זה. מרצה: צבי רבס טכנולוג ניסטק מרכז | <ul style="list-style-type: none"> Introduction of BGA, uBGA, QFN, LGA Reflow methods Inspection+Micro section Analysis Process Defects X-Ray inspection and Quality Standards | <ul style="list-style-type: none"> אנשי הנדסה אנשי ייצור אנשי תפ"י מהנדסי מערכת מהנדסי תהליך מנהלי פרויקטים |

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר קבוצת ניסטק www.nistec.com
וכן ניתן לפנות לקבוצת ניסטק - 03-9292555 main@nistec.com

Nistec Sunday Training - הרשמה

4th Round

ההרשמה באמצעות אתר ניסטק בכתובת: www.nistec.com
הכנסו ל- Contact Us, בחרו בתפריט Training Registration ומלאו את שם ההדרכה בה אתם מעוניינים.